

# Sächsischer Arbeitskreis **VDE / VDI** Elektronik-Technologie

Obmann: Herr Prof.Dr.-Ing.habil. W. Sauer  
 Koordinierung: Herr Dr.-Ing. R. Bauer  
 TU Dresden, Institut für Elektronik-Technologie  
 01062 Dresden

Telefon: 0351 / 463 5409 bzw. 6428  
 Fax: 0351 / 463 7069  
 e-mail: r.bauer@iet.et.tu-dresden.de  
 www: <http://www.et.tu-dresden.de/iet/iet.html>

## 22. Treffen des Sächsischen Arbeitskreises Elektronik-Technologie (VDE/VDI)

am **Donnerstag, 25. November 1999** **10.00 Uhr**

**Tagungsort:** **Treff-Hotel Leipzig**  
**Schongauer Str. 39 (beim Paunsdorf-Center)**  
**04329 Leipzig**

**Gastgeberfirma:** **SIEMENS AG**

Auf der letzten Veranstaltung vor dem Jahr 2000 steht die zukunftsorientierte Flachbaugruppenfertigung mit dem Schwerpunkt Bestücktechnik im Mittelpunkt. Das Treffen wurde gemeinsam mit Herrn Kaminski von der SIEMENS AG, die Gastgeberfirma ist, vorbereitet. In einer angenehmen Tagungsatmosphäre im Treff-Hotel sind Vorträge zu technischen und auch zu betriebswirtschaftlichen Aspekten geplant. Im Anschluß an die Vortragsreihe und Diskussion besteht die Möglichkeit, die neuentstandene, weitestgehend automatisierte Flachbaugruppenfertigung der SIEMENS AG in Leipzig-Taucha, Hertzstr. 7, zu besichtigen. Das 22. Treffen des Arbeitskreises Elektronik-Technologie werden wir gemeinsam mit der DVS Arbeitsgruppe Neue Weichlöttechniken durchführen.

**Thema:** **Flachbaugruppenfertigung für das Jahr 2000**

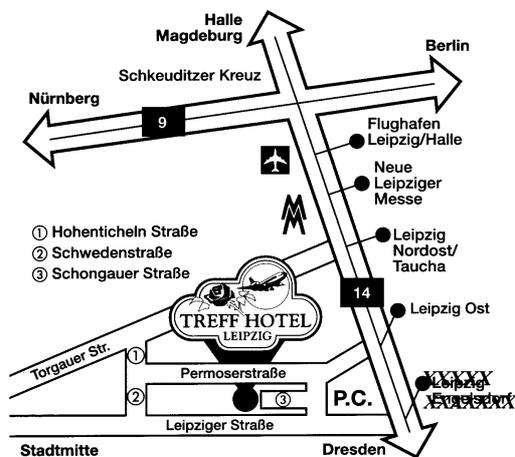
- 10:00 Uhr **Eröffnung des 22. Treffens des Arbeitskreises**  
 Herr Prof. Sauer, TU Dresden; Herr Kaminski, SIEMENS AG
- 10:15 Uhr **Zuverlässige Verarbeitung von CSPs, Bare-Dies für COB und FLIP-Chips im SMT-Prozeß**  
 Herr Schiebel, Siemens AG, PL EA.
- 11:15 Uhr **Pause**
- 11:30 Uhr **Productconsult und betriebswirtschaftliche Aspekte moderner Bestücktechnologie**  
 Frau Raschke, Herr Buchholz, Siemens AG, PL EA
- 12:00 Uhr **BGA-Reparatur auf einfache Art und Weise**  
 Herr Kurpiela - Applikationsingenieur Cooper Tools
- 12:30 Uhr **Mittag**
- 13:30 Uhr **Neue Leitklebstoffe für Anwendungen in der Mikroelektronik**  
 Herr Müller, Panacol-Elosol GmbH
- 14:00 Uhr **Entwicklungstrends von Weichlotpasten**  
 Herr Dr. Berek, Forschungsinstitut für Nichteisen-Metalle GmbH Freiberg
- 14:30 Uhr **Informationen vom VDE-Arbeitskreis Elektronik-Technologie und vom DVS-Arbeitskreis Neue Weichlöttechniken**  
 Herr Prof. Sauer, Herr Dr. Berek
- 15:00 Uhr **Transfer zum neuen Fertigungsbetrieb der SIEMENS AG in Leipzig-Taucha, Hertzstr. 7**
- 15:15 Uhr **Vorstellung der Siemens AG am Standort Leipzig und Fertigungsbesichtigung im Werk in Leipzig-Taucha**

Alle Interessenten sind zu dieser Veranstaltung herzlich eingeladen. Teilnahmemeldungen sind bis eine Woche vor der Veranstaltung an Herrn Dr. R. Bauer, TU Dresden, Institut für Elektronik-Technologie (Fax.-Nr.: 0351/ 463 7069 oder e-mail: r.bauer@iet.et.tu-dresden.de) erbeten. Aktuelle Informationen sind auch im Internet zu finden unter <http://www.et.tu-dresden.de/iet/iet.html>.

Hinweise zur Anfahrt:

Von der Autobahn Leipzig Ost-Engelsdorf Richtung Leipzig an der dritten Ampel (bezogen auf die Abfahrt aus Richtung Halle) links abbiegen, am Parkhaus vorbei, im Kreisverkehr rechts am BMW-Autohaus einbiegen und geradeaus fahren bis zum Parkplatz des Treff Hotels.

***Wir wünschen Ihnen eine angenehme Anreise!***



**ACHTUNG!**  
**Neue Autobahnabfahrt**  
**Leipzig Ost-Engelsdorf**



Schongauer Straße 39 • 04329 Leipzig  
 Telefon (03 41) 25 40  
 Telefax (03 41) 2 54 15 50  
 Sabre TX 18329 • Amadeus TX LEJLEI  
 Galileo TX 63286 • Worldspan TX LEJLEI